

# COMPANY RESEARCH AND ANALYSIS REPORT

|| 企業調査レポート ||

## フェローテック

6890 東証スタンダード市場

企業情報はこちら >>>

2026年1月6日(火)

執筆：客員アナリスト

寺島 昇

FISCO Ltd. Analyst **Noboru Terashima**



FISCO Ltd.

<https://www.fisco.co.jp>

## 目次

■ 要約	01
1. 2026年3月期中間期の業績概要	01
2. 2026年3月期の業績見通し	01
3. 中期経営計画の目標は変わらず	01
■ 会社概要	02
1. 会社概要	02
2. 事業セグメント	03
3. 特色、強み	03
■ 業績動向	03
1. 2026年3月期中間期の業績概要	03
2. セグメント別概況	05
3. 主な設備投資	06
4. 主なトピックス	06
■ 今後の見通し	07
1. 2026年3月期の業績見通し	07
2. 主要製品の現況と見通し	07
■ 中期経営計画	08
1. 中期経営計画の基本方針	08
2. 定量的目標 (KPI)	09
■ 株主還元策	10

## 要約

### 2026年3月期中間期は電子デバイスの貢献で0.6%の営業増益

フェローテック<6890>の主力事業は、真空シール、石英製品、セラミックス製品、CVD-SiC (化学蒸着法炭化ケイ素) 製品、磁性流体、サーモモジュールなどの様々な製品・装置・部品・素材等の製造である。加えて、半導体製造装置メーカー向けに各種部品等の洗浄サービスやシリコンウエーハの研磨なども行う企業である。

#### 1. 2026年3月期中間期の業績概要

2026年3月期中間期決算は、売上高が前年同期比4.3%増の140,980百万円、営業利益が同0.6%増の14,333百万円、経常利益が同16.5%減の12,923百万円、親会社株主に帰属する中間純利益が同31.4%減の6,308百万円となった。経常利益が減益となったのは主に為替差損による。また特別損失 (固定資産処分損) の計上で中間純利益の減益幅がさらに大きくなった。売上総利益率は製品構成の変化により0.7ポイント改善したが、販管費の増加により営業利益はほぼ横ばいにとどまった。事業別では、半導体等装置関連は増収減益、電子デバイスはサーモモジュールを中心に増収増益、車載関連はEV向けが低迷したが増収及び小幅増益、その他は引上げ装置の反動減で赤字となった。全体として強弱が混在したが、足元には回復の兆しが見られる。

#### 2. 2026年3月期の業績見通し

2026年3月期通期の業績は、売上高285,000百万円 (前期比3.9%増)、営業利益30,000百万円 (同24.5%増)、経常利益28,000百万円 (同9.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益16,000百万円 (同2.0%増) と予想しており、売上高予想は期初と変わっていないが、製品構成の変化により営業利益は期初予想 (28,000百万円) から上方修正された。通期での設備投資額は65,000百万円 (前期は51,776百万円)、減価償却費は27,000百万円 (同23,672百万円) を計画しており、期初計画と変わっていない。足元では半導体関連に上昇の気配があるようで、この予想が達成される可能性は高いだろう。

#### 3. 中期経営計画の目標は変わらず

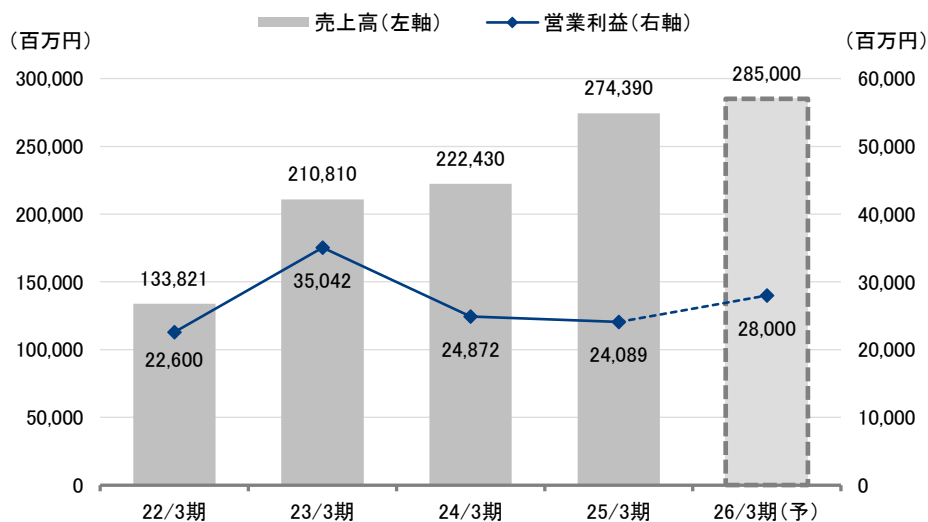
同社は、2028年3月期を最終年度とする中期経営計画を発表済みで、最終年度の定量的な目標として売上高4,000億円、営業利益470億円、営業利益率11.8%、ROE15.0%を掲げている。またこの間の設備投資額は、3ヶ年 (2026年3月期から2028年3月期) で1,400億円を計画している。現状では、この計画に沿って進捗しており、これらの目標数値は変えていない。株主還元策では、DOE (株主資本配当率) を採用し下限を3.5%に設定、総還元性向50%を目指す。この方針に沿って今期は年間配当金148.0円を予定している。

#### Key Points

- ・石英やセラミックス等の無機系製品の大手メーカー。半導体業界向けが多い
- ・2026年3月期中間期の営業利益は前年同期比0.6%増、通期では24.5%の営業増益予想
- ・中期経営計画の目標は変わらず2028年3月期に営業利益470億円を目指す

# 要約

## 業績推移



出所：決算短信よりフィスコ作成

## 会社概要

### 主要事業は半導体及び同製造装置メーカー向け部材の製造

#### 1. 会社概要

同社は2025年3月末現在(有価証券報告書)では、傘下に連結子会社80社、持分法適用会社13社を擁する純粋持株会社であったが、2025年7月1日付で国内事業子会社である(株)フェローテックマテリアルテクノロジーを吸収合併し、事業持株会社になるとともに、社名を(株)フェローテックに変更した。もともとは1980年に米国Ferrofluidics Corporation(現 Ferrotec (USA) Corporation)の日本法人(旧 日本フェローフルイディクス(株))として設立されたが、その後、親会社から分離独立し独自路線を歩んでいる。

現在の主力事業は、真空シール・金属加工、石英製品、セラミックス、CVD-SiC、磁性流体、サーモモジュール、パワー半導体基板など主に無機材料を使った様々な製品・装置・部品・素材等の製造・販売である。また、半導体製造装置メーカーやデバイスメーカー向けに各種部品等の洗浄や受託加工・組立サービスなどの事業も行っている。そのため、世界的に著名な大手半導体製造装置メーカーが主要顧客となっている。

## 2. 事業セグメント

前述のように同社は多くの製品を自社開発・製造すると同時にM&Aによって多くの企業を子会社化してきたことから、事業内容は多岐にわたる。事業セグメントは、半導体等装置関連(2025年3月期の売上高比率60.2%)、電子デバイス(同18.4%)、車載関連(同11.1%)、その他(同10.3%)の4つに分けられており、それぞれサブセグメントが置かれている。

## 3. 特色、強み

### (1) 無機系素材のパイオニア

同社は石英、シリコン、窒化ケイ素、シリコンカーバイド(SiC)など幅広い無機系素材の生成、加工などに長年携わってきた。そのため、社内にはこれらの素材に関する多くのノウハウ(素材の性質、生成方法、加工方法等)が蓄積されており、これが同社の特色でもあり強みと言える。

### (2) 製造装置も手掛ける

同社は、素材だけでなく各種の製造装置も手掛けており、製造装置に関するノウハウも持っている。そのため顧客に対しては、素材、加工部品、最終製品、製造装置など様々な提案(ソリューションの提供)を行うことができる。

### (3) ワンストップソリューションが可能

同社は、半導体製造装置内の部品の洗浄(取り外し、洗浄、据付)や製造装置の組立サービスなどの事業も展開しており、顧客にとっては素材の供給、部品加工、装置類の組立、部品洗浄などをワンストップで外注化(アウトソーシング)することが可能であり、これも同社の強みと言える。

### (4) 大手顧客との信頼関係

同社の主要製品は、主に半導体製造装置向け及び半導体製造プロセスで使われるため、主要顧客は世界でトップクラスの半導体製造装置メーカーが多い。同社はこれらの大手半導体製造装置メーカーに長年にわたり製品や部品を供給しており、これら顧客との深い信頼関係も同社の財産であり強みとなっている。

## 業績動向

### 2026年3月期中間期は0.6%の営業増益、電子デバイスがけん引

#### 1. 2026年3月期中間期の業績概要

##### (1) 損益状況

2026年3月期中間期決算は、売上高が前年同期比4.3%増の140,980百万円、営業利益が同0.6%増の14,333百万円、経常利益が同16.5%減の12,923百万円、親会社株主に帰属する中間純利益が同31.4%減の6,308百万円となった。

# 業績動向

主要セグメントは増収を確保したが、その他セグメントが前年同期の反動により大幅減収となったことから、全体の売上高は4.3%増にとどまった。売上総利益率は製品構成の変化により0.7ポイント改善したが、販管費がほぼ予算どおりの10.8%増となったことから、営業利益は前期並みにとどまった。営業外費用として為替差損1,257百万円(前年同期は742百万円の差益)が発生したことから、経常利益は前年同期比で減益となった。さらに特別損失(固定資産処分損)の計上で中間期純利益はさらに減益幅が大きくなった。

## 2026年3月期中間業績

(単位: 百万円)

	25/3期中間期		26/3期中間期		前年同期比	
	金額	売上比	金額	売上比	増減額	増減率
売上高	135,157	100.0%	140,980	100.0%	5,823	4.3%
売上総利益	38,111	28.2%	40,780	28.9%	2,669	7.0%
販管費	23,859	17.7%	26,446	18.8%	2,587	10.8%
営業利益	14,251	10.5%	14,333	10.2%	81	0.6%
経常利益	15,470	11.4%	12,923	9.2%	-2,546	-16.5%
中間純利益	9,190	6.8%	6,308	4.5%	-2,881	-31.4%
設備投資額※	22,882	16.9%	27,376	19.4%	4,493	19.6%
減価償却費	11,241	8.3%	13,249	9.4%	2,008	17.9%

※ 設備投資額 = 有形固定資産、無形固定資産の取得額の合計

出所: 決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

## 有利子負債が増加だが、為替の影響で有形固定資産が減少

### (2) 財務状況

2026年3月期中間期末の財務状況は、流動資産が296,468百万円(前期末比1,101百万円増)となった。主に為替の影響による現金及び預金の減少2,027百万円、受取手形、売掛金及び契約資産の減少3,698百万円、棚卸資産の増加5,040百万円による。固定資産は前期末比で2,131百万円減少し303,095百万円となった。有形固定資産は、期末の為替レート(子会社は6月末)の影響で2,712百万円減、無形固定資産は669百万円減、投資その他の資産は1,250百万円増であった。

負債合計は、285,993百万円(同8,949百万円増)となった。要因は、電子記録債務を含む支払手形及び買掛金の減少6,990百万円、短期借入金等(1年内償還予定の社債と1年内返済予定の長期借入金を含む)の増加6,581百万円、社債の増加6,288百万円、長期借入金の増加4,584百万円等による。この結果、有利子負債の合計額は179,751百万円となり、前期末(162,296百万円)から17,453百万円増加した。

また純資産合計は、313,570百万円(同9,979百万円減)となった。親会社株主に帰属する中間純利益の計上による利益剰余金の増加2,282百万円、円安進行に伴う為替換算調整勘定の減少18,069百万円、中国子会社への第三者割当増資による非支配株主持分の増加4,141百万円等によるものである。この結果、2026年3月期中間期末の自己資本比率は37.0%(前期末は39.4%)となった。

## サーモモジュール中心に電子デバイスがけん引

### 2. セグメント別概況

セグメント別では、半導体等装置関連の売上高が88,378百万円（前年同期比5.2%増）、セグメント利益は8,190百万円（同2.1%減）となった。金属加工製品、セラミックス、装置部品洗浄などは堅調であったが、石英坩堝の落ち込みが響いた。電子デバイス（新区分）では、売上高は28,090百万円（同21.7%増）、セグメント利益は5,823百万円（同45.9%増）となった。光トランシーバー向けサーモモジュールやパワー半導体用基板が伸長した。車載関連の売上高は15,991百万円（同11.8%増）、セグメント利益は1,454百万円（同9.9%増）となった。その他の売上高は8,520百万円（同37.9%減）、セグメント損失301百万円（前年同期は793百万円の利益）であった。

#### セグメント別売上高・営業利益

（単位：百万円）

	25/3期中間期		26/3期中間期			
	金額	構成比	金額	構成比	増減額	増減率
売上高	135,157	100.0%	140,980	100.0%	5,823	4.3%
半導体等装置関連	84,042	62.2%	88,378	62.7%	4,336	5.2%
真空シール・金属加工	19,347	14.3%	22,557	16.0%	3,210	16.6%
石英製品	16,134	11.9%	16,440	11.7%	306	1.9%
シリコンパーツ	7,172	5.3%	6,713	4.8%	-459	-6.4%
セラミックス	15,448	11.4%	19,099	13.5%	3,651	23.6%
CVD-SiC	3,992	3.0%	4,639	3.3%	647	16.2%
EBガン・LED蒸着装置	4,076	3.0%	3,932	2.8%	-144	-3.5%
ウエーハ加工	10	0.0%	-	-	-10	-100.0%
再生ウエーハ	1,251	0.9%	2,216	1.6%	965	77.2%
装置部品洗浄	7,061	5.2%	8,294	5.9%	1,233	17.5%
石英坩堝	9,547	7.1%	4,484	3.2%	-5,063	-53.0%
電子デバイス	23,085	17.1%	28,090	19.9%	5,005	21.7%
サーモモジュール	12,431	9.2%	14,639	10.4%	2,208	17.8%
パワー半導体基板	8,692	6.4%	10,009	7.1%	1,317	15.2%
磁性流体・その他	575	0.4%	616	0.4%	41	7.2%
センサ	1,387	1.0%	2,825	2.0%	1,438	103.7%
車載関連	14,304	10.6%	15,991	11.3%	1,687	11.8%
サーモモジュール	3,108	2.3%	2,639	1.9%	-469	-15.1%
パワー半導体用基板	9,628	7.1%	9,961	7.1%	333	3.5%
センサ	1,567	1.2%	3,390	2.4%	1,823	116.2%
その他	13,723	10.2%	8,520	6.0%	-5,203	-37.9%
営業損益	14,251	10.5%	14,333	10.2%	81	0.6%
半導体等装置関連	8,363	10.0%	8,190	9.3%	-172	-2.1%
電子デバイス	3,992	17.3%	5,823	20.7%	1,830	45.9%
車載関連	1,323	9.3%	1,454	9.1%	130	9.9%
その他	793	5.8%	-301	-3.5%	-1,094	-
調整額	-220	-	-833	-	-613	-

出所：決算短信、決算説明資料よりフィスコ作成

### 3. 主な設備投資

設備投資額（有形固定資産及び無形固定資産の取得等の合計）は27,376百万円（前年同期は22,882百万円）となった。主な投資内容は、熊本工場（部品洗浄）に23億円、石川第3工場（セラミックス等）に28億円、マレーシア（パワー基板）に22億円、常山4期（金属加工）に23億円など。減価償却費は13,249百万円（前年同期は11,241百万円）となった。

### 4. 主なトピックス

#### (1) Ex-China対応（マレーシア）

今後の欧米顧客向け量産拠点として、マレーシアにおいて基盤づくりを推進中である。

#### （マレーシア・クリム第1工場）

量産開始後、順調に生産量を増加させ、稼働率は向上している。想定よりも早く単月黒字化を達成した。今後、認証をさらに進め顧客への供給力を向上させるとともに、新規顧客獲得も目指す。

#### （マレーシア・クリム第2工場）

2025年6月の起工から基礎工事を終え、建屋工事へ移行し12月には棟上式を予定している。2026年下期の竣工に向けて予定通り進捗している。

#### (2) Ex-China対応（日本）

「日本回帰」をテーマに日本での製造拠点づくり（石川第3工場、熊本工場）が今期完了した。欧米及び日本顧客の需要取り込みをさらに加速させていく計画だ。

#### (3) 中国子会社の動向（上場子会社関連）

##### （FTSVA－FLHの子会社化を完了）

深圳証券取引所創業板に上場している安徽富樂德科技發展股份有限公司（FTSVA）（部品洗浄）が、株式交換によってパワー半導体用基板製造子会社である江蘇富樂華半導体科技股份有限公司（FLH）を子会社化した。パワー半導体用基板開発等を目的とした7.8億元（約161億円）の第三者割当増資も実施した。

##### CCMC－株式店頭登録・取引開始

半導体ウエーハ事業の持分法適用会社である杭州中欣晶圆半導体股份有限公司（CCMC）の株式が中国の店頭取引市場である中国新三板（全国中小企業株式譲渡システム）で店頭登録され、2025年10月22日より取引開始された。同時に新三板を通じて、固定資産購入や有利子負債返済等を目的とする6.1億元（約129億円）の第三者割当増資も実施した。



## ■ 今後の見通し

### 2026年3月期の営業利益は24.5%増へ上方修正

#### 1. 2026年3月期の業績見通し

2026年3月期の業績は、現時点で売上高285,000百万円(前期比3.9%増)、営業利益30,000百万円(同24.5%増)、経常利益28,000百万円(同9.6%増)、親会社株主に帰属する当期純利益16,000百万円(同2.0%増)と予想されており、売上高の予想は変更しないものの、営業利益と経常利益は期初予想(28,000百万円と26,000百万円)から上方修正された。これは、現在の市況において利益率の高い製品の売上構成比が上がると見られるためだ。下期に入っても、半導体業界を取り巻く環境に大きな変化はなく、同社製品に対する需要が本格的に回復するのは来期以降と見られるが、この予想が達成される可能性は高いだろう。通期での設備投資額は65,000百万円(前期は51,776百万円)、減価償却費は27,000百万円(同23,672百万円)を予想している。

セグメント別売上高は、半導体等装置関連は180,500百万円(前期比9.2%増)を予想している。真空シール・金属加工、セラミックス、部品洗浄は堅調に推移する見込みだが、石英坩堝は通期でも大幅減収を予想する。ただし収益性は改善を見込む。

電子デバイスは57,774百万円(同14.4%増)を予想する。好調な生成AIサーバ投資を背景に、光トランシーバー向けが増加し、サーモモジュールが堅調に推移して全体の業績をけん引する見込みだ。パワー半導体は、需要の伸び悩みや競争激化のなか、売上増加は確保できる見通しで通期予想を上方修正した。センサは、大泉製作所の決算期変更により、前期は第1四半期の売上計上がなかったため前期比で増加を予想している。

車載関連は、29,367百万円(同3.6%減)を予想する。EV需要の成長が鈍化、車載向けパワー半導体用基板の売上は下振れする見込みだ。センサは電子デバイスと同様に、大泉製作所の決算期変更により前期比増加を見込む。

その他は上半期同様の傾向が続き、17,357百万円(同38.4%減)と大幅減を予想している。

#### 2. 主要製品の現況と見通し

##### (1) 真空シール・金属加工

半導体製造装置メーカーの需要が堅調で、米国及び中国の金属加工需要は堅調で引き合いが増加、成長が継続する見込みである。売上高は前期比32.2%増の51,831百万円を予想している。

##### (2) 半導体材料(石英製品、シリコンパーツ、セラミックス、CVD-SiC)

石英製品は、顧客在庫の影響が薄れ、売上高は増加基調で前期比3.2%増の32,940百万円を見込む。シリコンパーツは顧客の在庫調整で減収となり、13,121百万円(同4.1%減)を予想する。セラミックスは米中の需要取り込みが続き、38,199百万円(15.2%増)を見込む。CVD-SiCは特定製品の減速により7,764百万円(5.2%減)を予想している。

### (3) 装置部品洗浄

中国における需要が増勢し着実な需要取込みで成長継続が望め、売上高は17,126百万円(同11.9%増)を見込む。

### (4) 石英坩堝

依然として太陽光発電向けが低調である。通期の売上高は8,681百万円(同31.5%減)と大幅減を見込むが、採算性は改善しつつある。

### (5) サーモモジュール(電子デバイス)

生成AI関連需要が増加し、売上高は30,884百万円(同13.4%増)となる見込みである。

### (6) パワー半導体用基板(電子デバイス)

需要の伸び悩みや競争激化のなかではあるが売上増加は確保できる見通しで、通期予想を上方修正して売上高は19,090百万円(同5.2%増)となる見込みである。

### (7) センサ(電子デバイス)

大泉製作所の決算期変更の影響(前期は9ヶ月分のみ)により、売上高は前期比63.8%増の6,506百万円を予想している。

### (8) サーモモジュール(車載関連)

市況悪化の影響もあり、車載向けTEの売上が減少し、売上高は4,892百万円(同23.7%減)となる見込み。

### (9) パワー半導体用基板(車載関連)

EV需要の成長が鈍化し需要が低調するなかで価格競争も激化し、DCB及びAMB※とも苦戦している。売上高は16,911百万円(同12.2%減)を予想している。

※ DCB=Direct Copper Bonding。AMB=Active Metal Brazing。いずれも同社製品の絶縁放熱回路基板。

### (10) センサ(車載関連)

大泉製作所の決算期変更の影響で大幅増収の売上高7,563百万円(同57.5%増)を見込む。

## ■ 中期経営計画

### 中期経営計画の基本方針と目標値は変えず

#### 1. 中期経営計画の基本方針

同社は、2028年3月期を最終年度とする中期経営計画の基本方針として、以下の4点を掲げている。

中期経営計画

(1) 事業成長

- ・半導体及び自動車関連の事業成長を追求し、業界上位の事業を拡大させる。
- ・マレーシア及び日本工場が中国外製造品の需要を取込み、中国工場が中国製造品の需要を取込む体制を強化する。

(2) 生産効率・競争力の強化

- ・量産能力をさらに高めるため、デジタル化・自動化等を進め、工場の生産効率向上・競争力強化を追求する。
- ・「品質は命」と考え品質管理の徹底を継続、研究開発体制の強化と新製品・新技術の開発を推進する。

(3) 人材強化・企業文化

- ・人材重視を重要な経営戦略と位置付け、高度人材の採用、研修制度の拡充、株式報酬制度(RSU・PSU)の導入を進める。
- ・企業文化は企業の礎であり、「顧客を尊敬、従業員を尊敬し、勤勉と信用を尊重し、着実に行動し、革新を追求する」を活動指針に掲げ、浸透を進める。

(4) 財務・株主還元



- ・新增設工場の早期立上げによる業績貢献をもって収益増強を図る。
- ・配当性向20%~30%を意識し、株主還元の拡充に努める。

2. 定量的目標 (KPI)

今後3年間の売上高、営業利益、利益率等の目標は、進行中の2026年3月期の営業利益と経常利益が上方修正されたが、それ以外は変わっておらず、最終年度である2028年3月期には売上高4,000億円、営業利益470億円、ROE15.0%、自己資本比率40.0%の維持を目指す。

定量的目標 (KPI)

(単位: 百万円)

	25/3期 実績	26/3期 予想	27/3期 計画	28/3期 計画
売上高	274,390	285,000	340,000	400,000
営業利益	24,089	28,000	35,000	47,000
(営業利益率)	8.8%	9.8%	10.3%	11.8%
親会社株主に帰属する 当期純利益	15,692	16,000	20,000	29,000
ROE	7.1%			15.0%
ROIC <sup>※1</sup>	3.9%			8.0%
自己資本比率	39.4%	40.0%		
設備投資額	51,777	65,000	45,000	30,000
1株当たり年間配当金(円)	141.0	148.0	DOE(連結株主資本配当率 <sup>※2</sup> )を採用し、下限を3.5%に設定 自己株式取得を機動的に検討、総還元性向50%を目指す	

※1: ROIC=親会社株主に帰属する当期純利益÷(有利子負債+純資産)。純資産は新株予約権、非支配株主持分除く

※2: 連結株主資本=資本金+資本剰余金+利益剰余金-自己株式。連結株主資本配当率=配当金総額÷連結株主資本

出所: 決算説明資料よりフィスコ作成

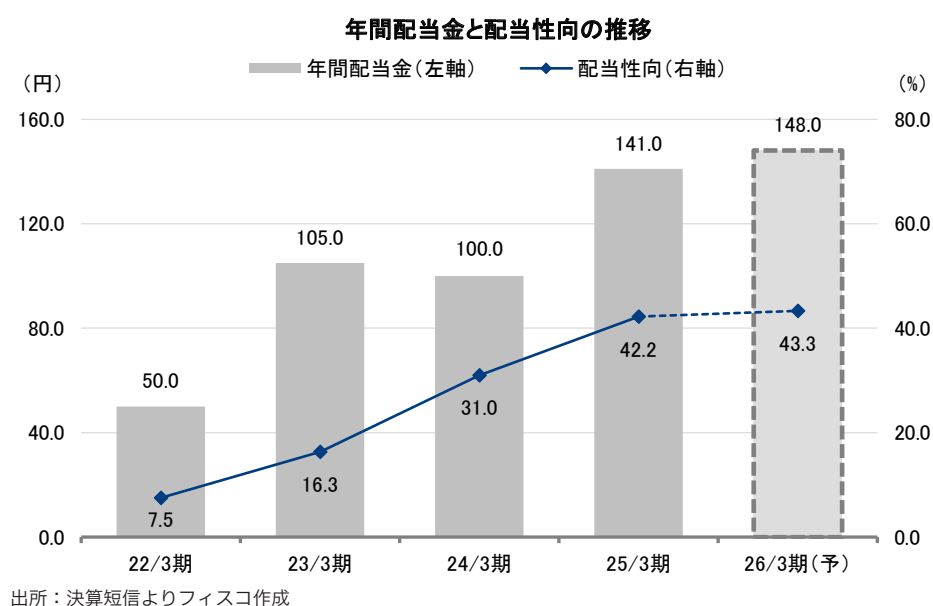
本資料のご利用については、必ず巻末の重要事項(ディスクレーマー)をお読みください。

Important disclosures and disclaimers appear at the back of this document.

## 株主還元策

### DOEを採用し、総還元性向50%を目指す

同社は、株主還元の基本方針を既存方針から変更し、今後は株主還元強化のため、DOEを採用し下限を3.5%に設定、総還元性向50%を目指す。これに基づいて、2026年3月期の年間配当は148.0円を予定している。



#### 重要事項 (ディスクレーマー)

株式会社フィスコ(以下「フィスコ」という)は株価情報および指数情報の利用について東京証券取引所・大阪取引所・日本経済新聞社の承諾のもと提供しています。本レポートは、あくまで情報提供を目的としたものであり、投資その他の行為および行動を勧誘するものではありません。

本レポートはフィスコが信頼できると判断した情報をもとにフィスコが作成・表示したのですが、フィスコは本レポートの内容および当該情報の正確性、完全性、的確性、信頼性等について、いかなる保証をするものではありません。

本レポートは、対象となる企業の依頼に基づき、企業への電話取材等を通じて当該企業より情報提供を受け、企業から報酬を受け取って作成されています。本レポートに含まれる仮説や結論その他全ての内容はフィスコの分析によるものです。

本レポートに掲載されている発行体の有価証券、通貨、商品、有価証券その他の金融商品は、企業の活動内容、経済政策や世界情勢などの影響により、その価値を増大または減少することもあり、価値を失う場合があります。本レポートは将来のいかなる結果をお約束するものでもありません。お客様が本レポートおよび本レポートに記載の情報をいかなる目的で使用する場合においても、お客様の判断と責任において使用するものであり、使用の結果として、お客様になんらかの損害が発生した場合でも、フィスコは、理由のいかんを問わず、いかなる責任も負いません。

本レポートに記載された内容は、本レポート作成時点におけるものであり、予告なく変更される場合があります。フィスコは本レポートを更新する義務を負いません。

本文およびデータ等の著作権を含む知的所有権はフィスコに帰属し、フィスコに無断で本レポートおよびその複製物を修正・加工、複製、送信、配布等することは強く禁じられています。

フィスコおよび関連会社ならびにそれらの取締役、役員、従業員は、本レポートに掲載されている金融商品または発行体の証券について、売買等の取引、保有を行っているまたは行う場合があります。

以上の点をご了承の上、ご利用ください。

#### ■お問い合わせ■

〒107-0062東京都港区南青山5-13-3

株式会社フィスコ

電話：03-5774-2443 (IRコンサルティング事業本部)

メールアドレス：support@fisco.co.jp